

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



541841

(43) 国際公開日
2004 年 7 月 29 日 (29.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/063122 A1

(51) 国際特許分類:
B01D 39/20, 46/00, B01J 32/00, 35/04 C04B 37/00,

Jun) [JP/JP]. 金子 隆久 (KANEKO, Takahisa) [JP/JP].
和田 幸久 (WADA, Yukihisa) [JP/JP].

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/000199

(74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); 〒
1050001 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一
ビル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2004 年 1 月 14 日 (14.01.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-006112 2003 年 1 月 14 日 (14.01.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本
碍子株式会社 (NGK INSULATORS, LTD.) [JP/JP]; 〒
4678530 愛知県名古屋市長区瑞穂区須田町 2 番 5 6 号
Aichi (JP).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が
可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,
KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU,

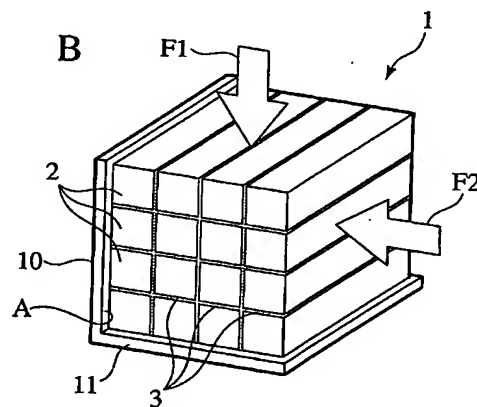
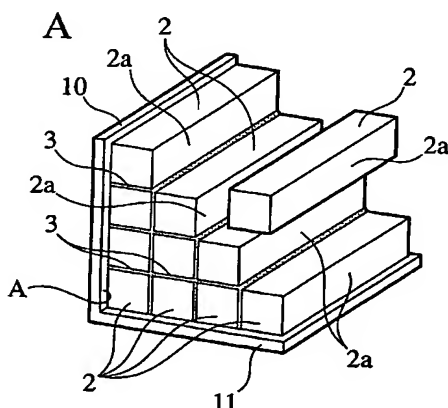
(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤田 純 (FUJITA,

/続葉有/

(54) Title: METHOD OF JOINING CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE BODY

(54) 発明の名称: セラミックハニカム構造体の接合方法



(57) Abstract: Porous honeycomb segments (2) are layered with adhesive layers interposed between each surface (2a) to be adhered of the segments and the next. After a predetermined number of honeycomb segments are layered, the whole of the layered segments is subjected simultaneously to main pressing (F1, F2) through porous honeycomb segments (2) positioned in the outermost layer. The pressure of the main pressing acts simultaneously to all of the individual honeycomb segments (2) and does not act as tearing force to any of the honeycomb segments (2).

(57) 要約: 多孔質ハニカムセグメント(2)の各々は、各々の被接着面(2 a)間に接着剤層を介在させて積層されると共に、所定の個数を積層後、最外層に位置する多孔質ハニカムセグメント(2)を介して全体を同時に本加圧(F 1、F 2)する。このときの本加圧力は、個々のハニカムセグメント(2)に対してもその全体に同時に作用することになって、いずれのハニカムセグメント(2)に対しても剥がす力となって作用することがない。

WO 2004/063122 A1



MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

明 細 書

セラミックハニカム構造体の接合方法

5 技術分野

本発明は、例えば、内燃機関、ボイラー、化学反応機器及び燃料電池用改質器等の触媒作用を利用する触媒用担体又は排ガス中の微粒子捕集フィルター等に用いられるセラミックハニカム構造体の接合方法に関する。

10

背景技術

この種のセラミックハニカム構造体 100 は、図 1 に示すように、隔壁により仕切られ軸方向に貫通する多数の流通孔 4 を有する多孔質ハニカムセグメント 2 が接着剤層 3 を介して複数個結束されて構成されている。

15

文献 1：特開 2000-7455 号公報

すなわち、セラミックハニカム構造体 100 は、四角柱形状の 16 個の多孔質ハニカムセグメント 2 を、縦横 4 列組み合わせて接着剤層 3 を介して互いに接合することによって構成されている。

20

このときの接合は、多孔質ハニカムセグメント 2、2 の被接着面 2a、2a 間に接着剤層 3 を介在させた後、前記ハニカムセグメント 2、2 に押圧力を加えつつ振動を付与することにより行う。

25

すなわち、接合工程は、図 2 に示すように、まず被接着面 2a に下地層を形成した第 1 の多孔質ハニカムセグメント 2 を支持治具 50 の切れ込み部 51 の最下部に載置する。次に、1 個の被接着面 2a に下地層を形成し、さらに下地層の上に接着剤を塗布した第 2 の多孔質ハニカムセグメント 2 を、第 1 のハニカムセグメント 2 と被接着面 2a 同士が接着

剤を挟んで対向するようにして密接配置される（図 2 A 参照）。この状態で、2 個のハニカムセグメント 2、2 の端面を押圧プレート（図示せず）で押圧して予め位置決めしておく。さらに、後のハニカムセグメント 2 に押圧治具 5 2 を当接させて鉛直方向に押圧すると共に、被接着面 2 a、2 a を相互にずれる方向に振動を付与する。これにより第 1、第 2 のハニカムセグメント 2、2 を接合することができる。

次に、1 個の被接着面 2 a に下地層を形成し、さらに下地層の上に接着剤を塗布した第 3 の多孔質ハニカムセグメント 2 を、第 1 のハニカムセグメント 2 の他の被接着面 2 a と被接着面 2 a 同士が接着剤を挟んで対向するようにして密接配置される（図 2 B 参照）。この状態で第 2 のハニカムセグメント 2 と同様に、第 3 のハニカムセグメント 2 を第 1 のハニカムセグメント 2 に接合することができる。

さらに、2 個の被接着面 2 a、2 a に下地層を形成し、さらに下地層の上に接着剤を塗布した第 4 の多孔質ハニカムセグメント 2 を、第 2 および第 3 のハニカムセグメント 2、2 間に密接配置される（図 2 C 参照）。この状態で第 2 および第 3 のハニカムセグメント 2 と同様に、第 4 のハニカムセグメント 2 を第 2 および第 3 のハニカムセグメント 2、2 間に接合することができる。

さらに次に、1 個の被接着面 2 a に下地層を形成し、さらに下地層の上に接着剤を塗布した第 5 の多孔質ハニカムセグメント 2 を、第 2 のハニカムセグメント 2 の他の被接着面 2 a と被接着面 2 a 同士が接着剤を挟んで対向するようにして密接配置される（図 2 D 参照）。この状態で前工程と同様に、第 5 のハニカムセグメント 2 を第 2 のハニカムセグメント 2 に接合することができる。

以降同様に、各ハニカムセグメント 2 毎に押圧と振動を付与して順次接合していき、最後に、2 個の被接着面 2 a、2 a に下地層を形成し、さらに下地層の上に接着剤を塗布した第 1.6 の多孔質ハニカムセグ

メント2を、押圧と振動を付与して接合することにより、セラミックハニカム構造体100の接合工程を完成させることができる（図2E参照）。

しかしながら、従来の接合方法は、各多孔質ハニカムセグメント2毎
5 に押圧と振動を付与して順次接合していくものであるから、積層順位の
早い下部のセグメント（前述の第1の多孔質ハニカムセグメント2の周
辺部に位置するセグメント）は最後のハニカムセグメント（前述の例で
は、第16の多孔質ハニカムセグメント2）の接合終了まで振動と加圧
10 力が伝達されることになり、この伝達力は相互に接合しているハニカム
セグメント2、2に対して剥がす力となって作用するため、下部のハニ
カムセグメントを接合している接着剤層3が剥離し、ひいては部分的に
接着強度の低下を招く、という課題を有している。

そこで、この発明は、各多孔質ハニカムセグメントの積層順位に拘わ
らず各ハニカムセグメントを接合している接着剤層を積層時のままの状
15 態に維持することができ、以て全体のハニカムセグメントを所望の接着
強度で均一に接合することができるセラミックハニカム構造体の接合方
法を提供することを目的としている。

発明の要旨

20 前記目的を達成するために、本発明の第1の特徴は、隔壁により仕切
られ軸方向に貫通する多数の流通孔を有する多孔質ハニカムセグメント
が、接着剤層を介して複数個結束されて構成されるセラミックハニカム
構造体の接合方法であって、

前記多孔質ハニカムセグメントの各々は、各々の被接着面間に前記接
25 着剤層を介在させて積層されると共に、所定の個数を積層後、最外層に
位置する前記多孔質ハニカムセグメントを介して全体を同時に本加圧す
ることにより接合されることにある。

本発明の第 1 の特徴によれば、多孔質ハニカムセグメントを所定の個数積層後、最外層に位置する前記多孔質ハニカムセグメントを介して全体を同時に本加圧するようにしたので、このときの本加圧力は、全てのハニカムセグメントに対して同時に作用することになって、いずれのハニカムセグメントに対しても剥がす力となって作用することがない。

また、本発明の第 2 の特徴は、本発明の第 1 の特徴を有するセラミックハニカム構造体の接合方法において、

前記多孔質ハニカムセグメントの各々は、積層時に前記本加圧よりも弱い圧力で予備加圧されることにある。

10 本発明の第 2 の特徴によれば、予備加圧時に他の接合済みのハニカムセグメントの移動を伴うことなく、積層時に巻き込んだ気泡を逃がすことができる。

また、本発明の第 3 の特徴は、本発明の第 2 の特徴を有するセラミックハニカム構造体の接合方法において、

15 前記予備加圧は、 0.5 kgf/cm^2 以下の圧力で行うことにある。

このため本発明の第 3 の特徴によれば、予備加圧時のハニカムセグメントの剥がれを防ぐことができると共に、脱気泡作用をも奏することができる。

20 図面の簡単な説明

図 1 は、従来のセラミックハニカム構造体の接合方法の説明図である。

図 2 A 乃至 2 E は、従来のセラミックハニカム構造体の接合方法のさらに詳細な説明図である。

25 図 3 は、本発明の一実施形態としてのセラミックハニカム構造体の接合方法の説明図で、図 3 A は積層途中工程を、図 3 B は積層最終工程をそれぞれ示す。

図 4 は、本発明の一実施形態の接合方法の積層最終工程における本加圧を説明する説明図である。

図 5 は、本発明の他の実施形態としてのセラミックハニカム構造体の接合方法の説明図で、図 5 A は積層途中工程を、図 5 B は積層最終工程をそれぞれ示す。

図 6 A は供試ハニカムセグメントの斜視図であり、図 6 B は供試ハニカムセグメントを接合して形成したセラミックハニカム構造体の斜視図である。

10 発明を実施するための最適な形態

以下、本発明を実施するための最適な形態を説明する。なお、図 1 および図 2 に示す構成要素と同一のものは、同一符号を付してその説明を簡略にすることにする。

図 3 は、本発明の一実施形態としてのセラミックハニカム構造体 1 の接合方法を示す。このセラミックハニカム構造体 1 は、隔壁により仕切られ軸方向に貫通する多数の流通孔を有する多孔質ハニカムセグメント 2 が、接着剤層 3 を介して複数個結束されて構成される。このときの多孔質ハニカムセグメント 2 は、図 1 に示すものと同様のものである。図 3 では、流通孔 4 を省略している。

また、このときの接合方法では、多孔質ハニカムセグメント 2 の各々は、各々の被接着面 2 a、2 a 間に接着剤層 3 を介在させて積層されると共に、所定の個数を積層後、最外層に位置する多孔質ハニカムセグメント 2、2、…を介して全体を同時に本加圧することにより接合される。このときの本加圧は、図 3 B 中、垂直下方向矢印 F 1 と、水平方向矢印 F 2 で示している。

具体的には、多孔質ハニカムセグメント 2 は、原料として、例えば炭化珪素、窒化珪素、コージェライト、アルミナ、ムライト、ジルコニア

、 燐酸ジルコニウム、アルミニウムチタネート、チタニア及びこれらの
組み合わせよりなる群から選ばれる少なくとも１種のセラミックス、F
e－C r－A l系金属、ニッケル系金属又は金属S iとS i C等を用い
、これにメチルセルロース及びヒドロキシプロポキシルメチルセルロー
5 ス等のバインダー、界面活性剤及び水等を添加して、可塑性の坏土を作
製する。

この坏土を、例えば押出成形し、隔壁により仕切られた軸方向に貫通
する多数の流通孔４を有する四角柱形状のハニカム成形体を成形する（
図６参照）。これを、例えばマイクロ波及び熱風などで乾燥した後、焼
10 成することにより、図６に示すような多孔質ハニカムセグメント２を製
造することができる。

本発明において、ハニカムセグメント２を製造した後、これらのハニ
カムセグメント２、２、…を、接合一体化する。本発明は、この接合方
法に特徴を有している。

15 この接合方法は、まず図３Ａに示すように、縦受板１０と横受板１１
とにより、Ｌ字状断面の收容エリアＡが形成されており、この收容エリ
アＡ内にハニカムセグメント２の各々は、各々の被接着面２a、２a間
に接着剤層３を介在させて積層される。この積層は、２面を縦受板１０
および横受板１１に沿わせて行われる。

20 接着剤層３の接着剤は、ハニカムセグメント２と同様の組成のセラミ
ックスを含むスラリーが好ましく、例えば、ハニカムセグメント２の構
成成分と共通のセラミックス粉に、セラミックファイバー等の無機繊維
、有機・無機のバインダー及び水などの分散媒を添加したものなどが好
ましく、更にS iゾルなどのゾル状物質を含むことも好ましい。この接
25 着剤をハニカムセグメント２の被接着面２aに施与することにより接着
剤層３を形成することができる。この接着剤層３の形成は、積層前のハ
ニカムセグメント２に対して行ってもよく、あるいは既に積層されてい

るハニカムセグメント2の露出している被接着面2aに対して行ってもよい。また積層は、ハニカムセグメント2を1個ずつ積み重ねることにより行われる。

次に、図3Bに示すように、ハニカムセグメント2を所定の個数（本
5 実施形態では、16個）積層後、最外層に位置する多孔質ハニカムセグメント2、2、…を介して全体を同時に矢印F1およびF2方向に本加圧する。このときの本加圧は、積層体の2面が縦受板10および横受板11で覆われているので、他の2面の全体を同時に矢印F1およびF2方向に本加圧する。このときの加圧動力は、エアシリンダ、あるいは油
10 圧シリンダ等が用いられる。

このときの本加圧は、好ましくは図4に示すように、最外層の多孔質ハニカムセグメント2の側面の略中央に当接する押圧リブ12aを、最外層に位置する多孔質ハニカムセグメント2の数だけ押圧面12bに備えた押圧具12を用いて行うことができる。押圧リブ12aは、ハニカ
15 ムセグメント2の側面の2つの短い辺の略中央を相互に結ぶ線上に当接されることが好ましい。

この構成では、最外層の多孔質ハニカムセグメント2の側面と押圧面12bとの間に、押圧リブ12aの高さ分の隙間が形成されるので、はみ出た接着剤の押圧面12bへの付着を避けることができる。

20 このようにセラミックハニカム構造体1は、多孔質ハニカムセグメント2を所定の個数積層後、最外層に位置する多孔質ハニカムセグメント2を介して全体を同時に本加圧するようにしたので、このときの本加圧力F1およびF2は、全てのハニカムセグメント2に対して同時に作用することになって、いずれのハニカムセグメント2に対しても剥がす力
25 となって作用することがない。

これにより接着剤層3の異常な剥離を防ぐことができる。したがって、各ハニカムセグメント2を接合している接着剤層3を、積層時のまま

の状態に維持することができるので、各多孔質ハニカムセグメント2は、その積層順位に拘わらず所望の接着強度で均一に接合することができる。

図5は、本発明の他の実施形態としてのセラミックハニカム構造体1の他の接合方法を示す。この接合方法では、多孔質ハニカムセグメント2の各々は、積層時に本加圧よりも弱い圧力で予備加圧される点が異なるだけで、他の構成は前述した一の実施形態と同様になっている。予備加圧は、図3(a)中、垂直下方向矢印f1と、水平方向矢印f2で表示している。ここで「積層時」とは、「第nのハニカムセグメント2が第nの所定位置に配置されてから、第(n+1)のハニカムセグメント2が第(n+1)の所定位置に配置されるまで」という意味である(nは、自然数)。

すなわち、各多孔質ハニカムセグメント2は、図5Aに示すように、各々の被接着面2a、2a間に接着剤層3を介在させて積層されると共に、その積層時に各多孔質ハニカムセグメント2毎に矢印f1およびf2方向に予備加圧を行う。このようにしてハニカムセグメント2を所定の個数(本実施形態では、16個)積層後、図5Bに示すように、最外層に位置する多孔質ハニカムセグメント2、2、…を介して全体を同時に矢印F1およびF2方向に本加圧する。

このように本実施形態に係る接合方法によれば、予備加圧が、本加圧よりも弱い圧力で行われるので、予備加圧時に他の接合済みのハニカムセグメント2の移動を伴うことなく、積層時に巻き込んだ気泡を逃がすことができる。したがって、積層時に、ハニカムセグメント2の移動に伴う接着剤層3の剥離もなく、かつ脱気泡作用が得られるので、セラミックハニカム構造体1の接着強度を一層向上させることができる。

また好ましくは、予備加圧は、 0.5 kgf/cm^2 以下の圧力で行う。

この構成では、予備加圧時のハニカムセグメント2の剥がれを防ぐことができると共に、脱気泡作用をも奏することができ、これによりセラミックハニカム構造体1の接着強度を一層確実に向上させることができる。因みに、予備加圧力が 0.5 kgf/cm^2 を越えるときは、予備加
5 圧時に他の接合済みのハニカムセグメント2を移動させることになり、この移動に起因して接着剤層3の剥離が生じる。

以下、実施例について説明する。

実施例 1

図6は、供試ハニカムセグメント2（図6A）、および16個の供試
10 ハニカムセグメント2を接着剤層3を介して接合することによって構成されるセラミックハニカム構造体1（図6B）を示す。

供試ハニカムセグメント2は、 $a = 35 \text{ mm}$ 、 $b = 35 \text{ mm}$ 、 $c = 15.2 \text{ mm}$ の大きさの四角柱に形成されている。

接着剤層3を形成する接着剤は、組成がSiCが39質量%、アルミ
15 ノシリケートが30質量%、コロイダルシリカが20質量%、無機系可塑剤が1質量%、水が10質量%で、粘度350pのものをを用いた。

接合方法は、図3に示す接合方法を採用したものを実施例1とし、ハニカムセグメント2を1個ずつ積層すると共に、積層時に加圧および振動を付与する接合方法を採用したものを比較例1とした。

20 接合条件：実施例1では、加圧面圧 1.5 kgf/cm^2 で本加圧を行った。

比較例1では、積層時の加圧を加圧面圧 1.5 kgf/cm^2 で行うと共に、振動の付与を振動周波数200Hzで行った。

考察：実施例1および比較例1を採用して、それぞれセラミックハニカム構造体1を10個ずつ作製した。そして各セラミックハニカム構造
25 体1毎に、ハニカムセグメント2、2間の境界部位S1～S24の接着

剤層 3 の振動の伝播による接着剤層界面の剥離の有無を肉眼観察し、剥離の生じている境界部位の個数を表 1 にまとめた。

【表 1】

接 合 方 法	サ ン プ ル									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
実 施 例 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較 例 1	8	10	12	3	4	7	5	9	11	12

- 5 表 1 から明らかなように、比較例 1 では剥離の生じている境界部位は、セラミックハニカム構造体 1 個当たり 3 ～ 12 個観察されたが、実施例 1 では剥離の生じている境界部位は観察されなかった。これから実施例 1 は、比較例 1 に比べてセラミックハニカム構造体 1 の接合強度を向上させ得ることが理解できる。

10 実施例 1、2、3

- 実施例 1 は、図 3 に示す接合方法を採用したものであり、実施例 2 は、図 5 に示す接合方法で予備加圧力 0.25 kgf/cm^2 を採用したものであり、実施例 3 は、図 5 に示す接合方法で予備加圧力 0.5 kgf/cm^2 を採用したものであり、比較例 2 は、図 5 に示す接合方法で予備加圧力 1 kgf/cm^2 を採用したものであり、比較例 3 は、図 5 に示す接合方法で予備加圧力 1.5 kgf/cm^2 を採用したものであり、比較例 4 は、図 5 に示す接合方法で予備加圧力 2 kgf/cm^2 を採用したものであり、比較例 5 は、図 5 に示す接合方法で予備加圧力 2.5 kgf/cm^2 を採用したものである。

- 20 このとき実施例 1、2、3、および比較例 2、3、4、5 の本加圧は、圧力 1.0 kgf/cm^2 で行った。他の要件は、全て前述した実施例 1 と同一にした。

考察：実施例 1、2、3、および比較例 2、3、4、5 を採用して、それぞれセラミックハニカム構造体 1 を作製した。そして各接合方法毎に、予備加圧時のハニカムセグメント 2 の剥がれ現象の有無を肉眼観察すると共に、作製したセラミックハニカム構造体 1 の接着剤層 3 中の気泡の割合、およびハニカムセグメント 2、2 間の接合強度を測定した。

気泡の割合の測定は、接着剤とハニカムセグメントを界面で切断し、その切断面をパソコンに繋いだスキャナーで画像として取り込み、画像処理を施して全体面積に対する気泡の面積割合を算出した。

また、接合強度の測定方法は、JIS R1601 に従って所定の強度試験用サンプルを切り出し、3 点曲げ接合強度の測定を行った。

結果を、表 2 にまとめた。

【表 2】

接 合 方 法	予備加圧力 (Kgf/cm ²)	予備加圧時 の剥れ	気泡の割合	接 合 密 度 (Kgf/cm ²)
実 施 例 1	なし	無	25%	250
実 施 例 2	0.25	無	5%	310
実 施 例 3	0.5	無	0%	340
比 較 例 2	1	有	0%	—
比 較 例 3	1.5	有	0%	—
比 較 例 4	2	有	0%	—
比 較 例 5	2.5	有	0%	—

表 2 中、予備加圧時のハニカムセグメント 2 の剥がれ現象の有無を「予備加圧時の剥れ」の項目に、接着剤層 3 中の気泡の割合を「気泡の割合」の項目に、およびハニカムセグメント 2、2 間の接合強度を「接合強度」の項目に示した。

表 2 から明らかなように、 0.5 kg f / cm^2 以下の圧力の予備加圧を採用した実施例 2、3 の接合方法によれば、予備加圧時および本加圧時のハニカムセグメント 2 の剥がれ現象の発生は認められなかったばかりか、気泡の割合も実施例 1 以下となって実施例 1 を上回る接合強度が得られる。

実施例 1 の接合方法は、予備加圧がないので、その分気泡の割合が増加して、接合強度の低下を招くが、本加圧時のハニカムセグメント 2 の剥がれ現象の発生は認められなかった。

これに対して、 1 kg f / cm^2 以上の圧力の予備加圧を採用した比較例 2、3、4、5 の接合方法によれば、予備加圧時のハニカムセグメント 2 の剥がれ現象の発生が認められ、セラミックハニカム構造体 1 を完成させるに至らなかった。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明の第 1 の特徴によれば、本加圧力は、個々のハニカムセグメントに対してもその全体に同時に作用することになって、いずれのハニカムセグメントに対しても剥がす力となって作用することがないので、各ハニカムセグメントを接合している接着剤層を、積層時のままの状態に維持することができ、これにより各多孔質ハニカムセグメントは、その積層順位に拘わらず所望の接着強度で均一に接合することができる。

また、本発明の第 2 の特徴によれば、予備加圧時に他の接合済みのハニカムセグメントの移動を伴うことなく、積層時に巻き込んだ気泡を逃がすことができるので、本発明の第 1 の特徴の効果に加えて、接着強度を一層向上させることができる。

また、本発明の第 3 の特徴によれば、予備加圧を、 0.5 kg f / cm^2 以下の圧力で行うようにしたので、予備加圧時のハニカムセグメント

の剥がれを防ぐことができると共に、脱気泡作用をも奏することができ、これにより本発明の第 3 の特徴の効果に加えて、接着強度を一層確実に向上させることができる。

請求の範囲

1. 隔壁により仕切られ軸方向に貫通する多数の流通孔を有する多孔質ハニカムセグメントが、接着剤層を介して複数個結束されて構成されるセラミックハニカム構造体の接合方法であって、

前記多孔質ハニカムセグメントの各々は、各々の被接着面間に前記接着剤層を介在させて積層され、

- 所定の個数を積層後、最外層に位置する前記多孔質ハニカムセグメントを介して全体を同時に本加圧することにより接合されることを特徴とする。

2. 請求項1に記載のセラミックハニカム構造体の接合方法であって、

- 前記多孔質ハニカムセグメントの各々は、積層時に前記本加圧よりも弱い圧力で予備加圧されることを特徴とする。

3. 請求項2に記載のセラミックハニカム構造体の接合方法であって、

- 前記予備加圧は、 0.5 kgf/cm^2 以下の圧力で行うことを特徴とする。

FIG. 1

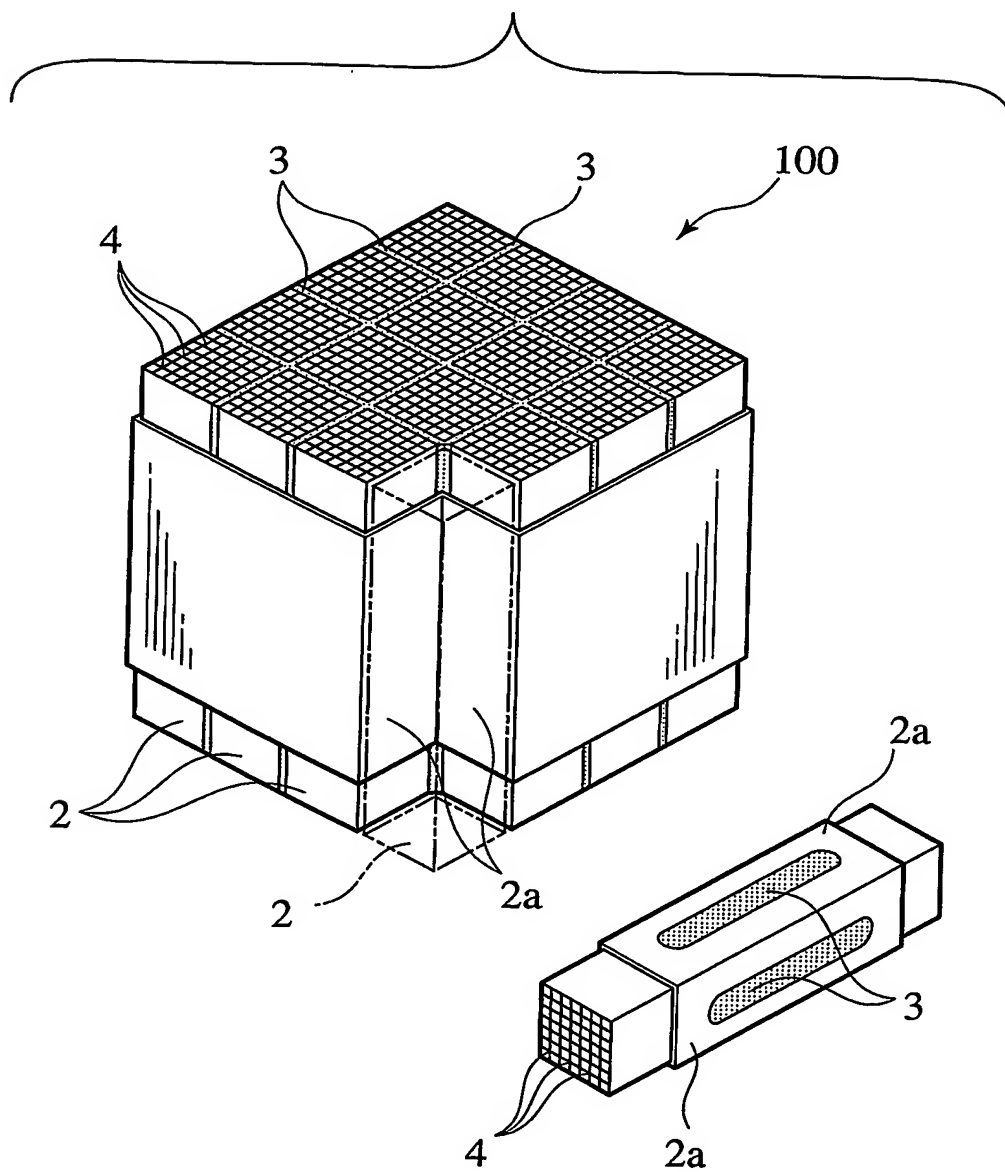


FIG.2A

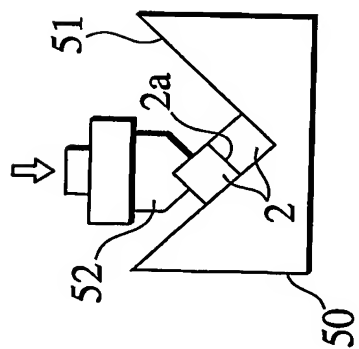


FIG.2B

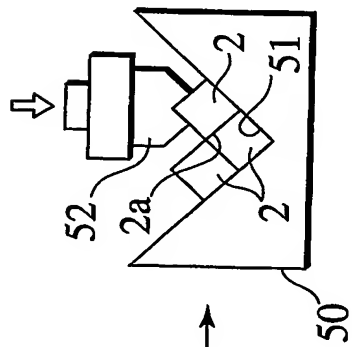


FIG.2C

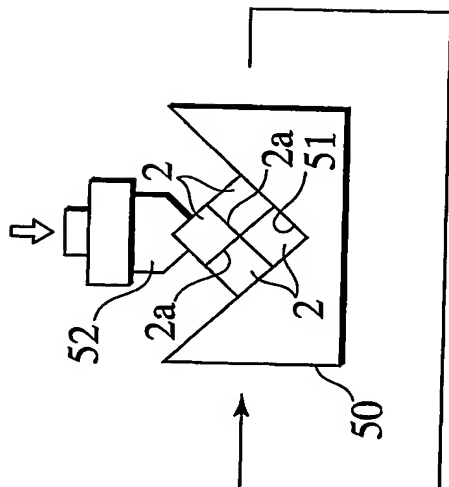


FIG.2D

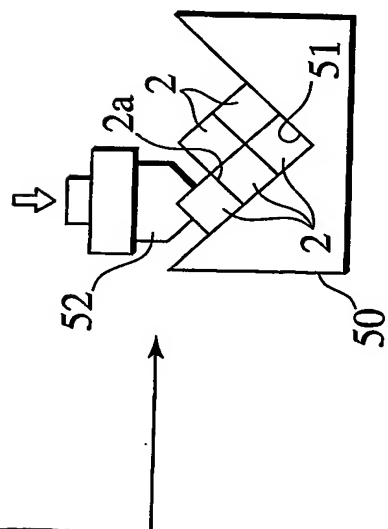


FIG.2E

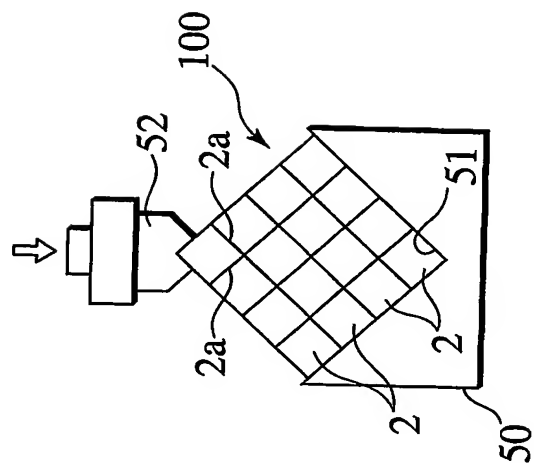


FIG.3A

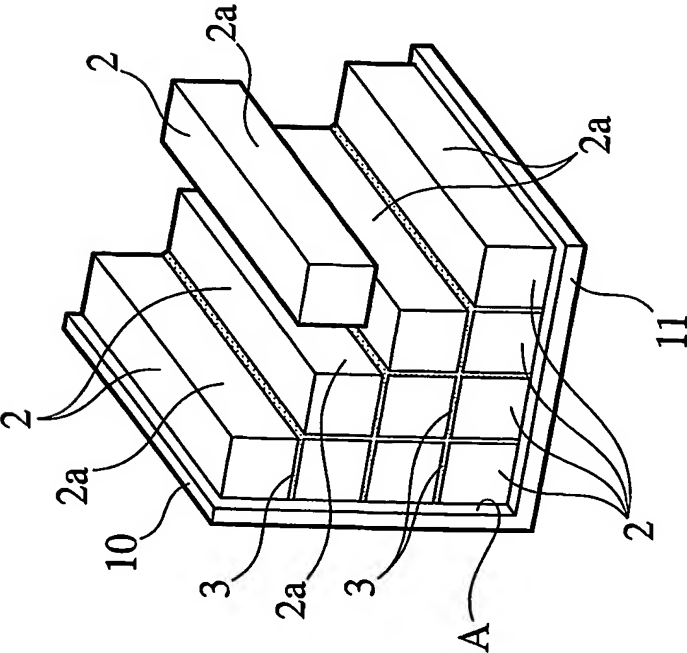


FIG.3B

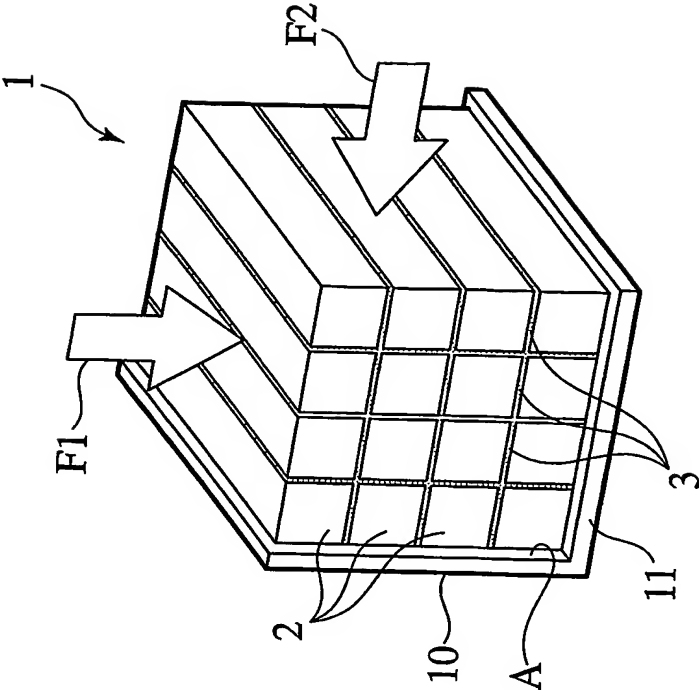
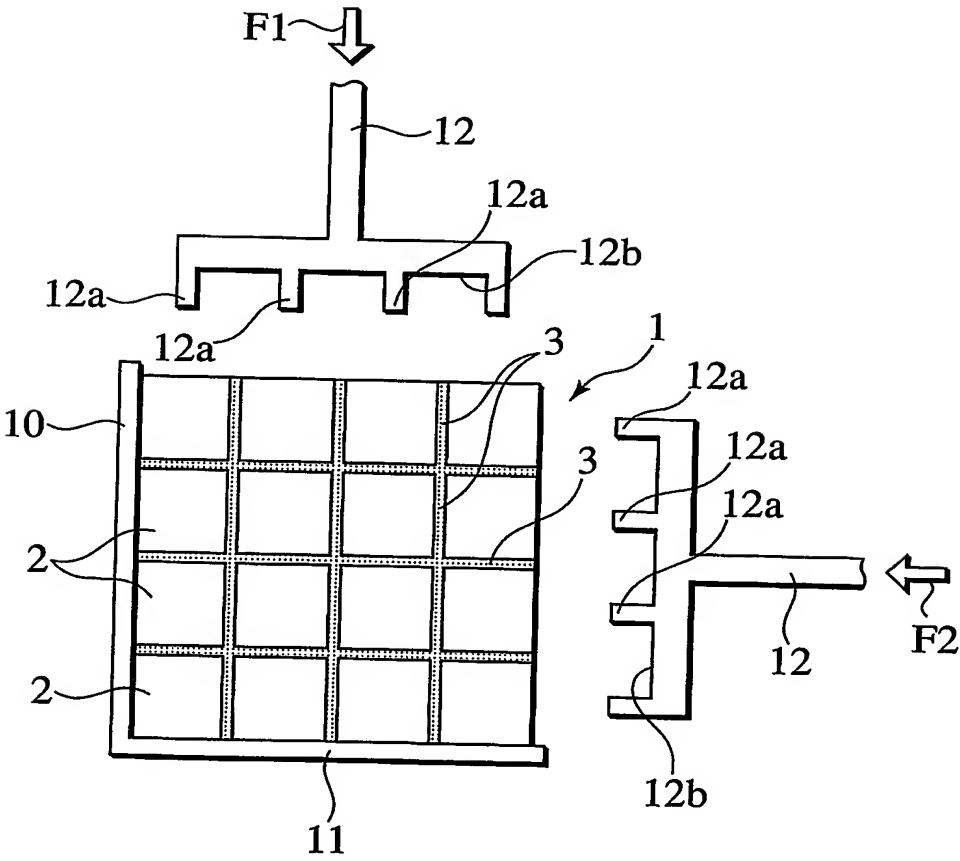


FIG.4



5/6

FIG.5A

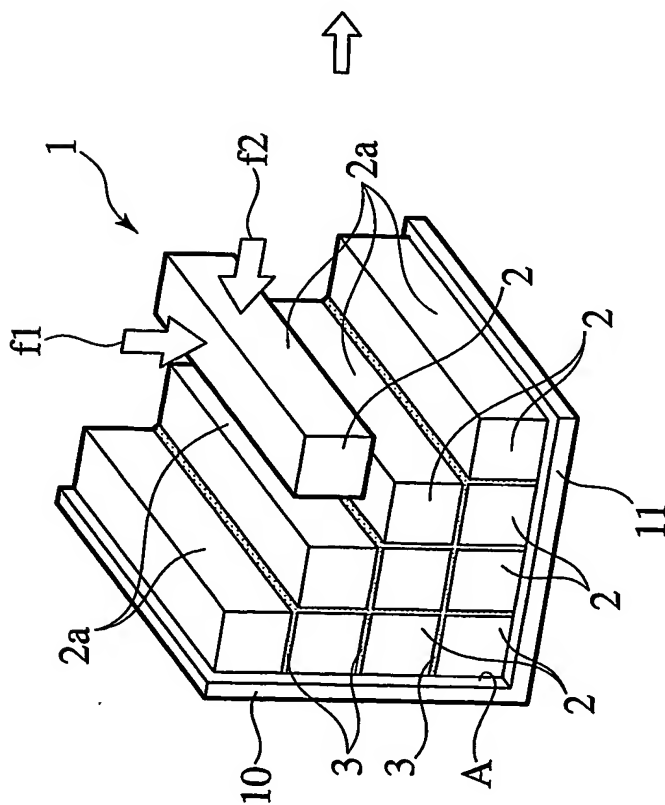
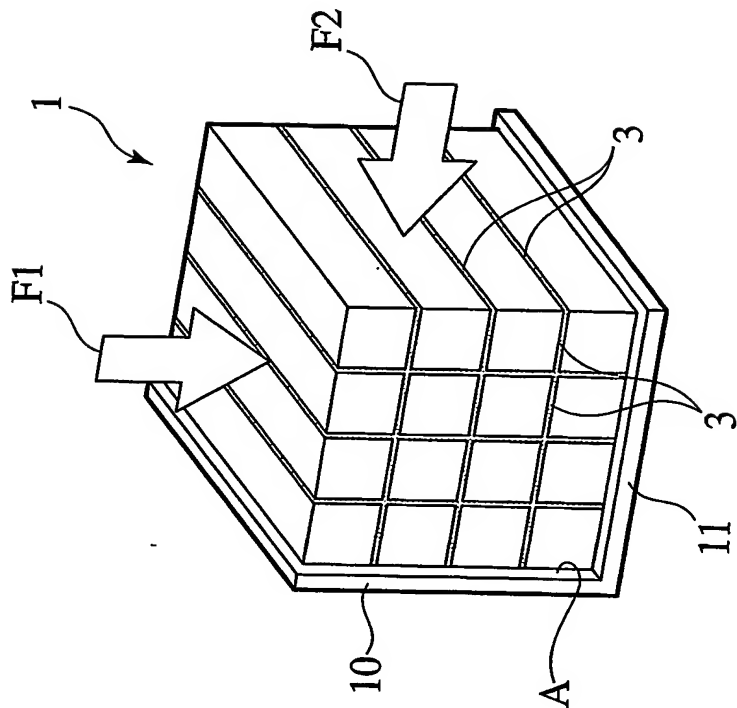


FIG.5B



6/6

FIG.6A

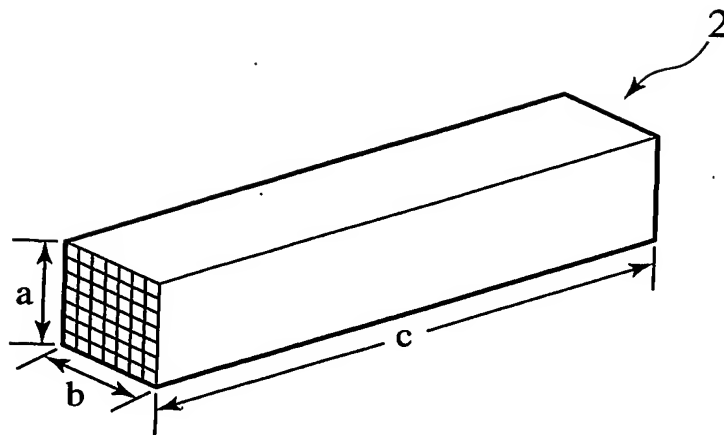
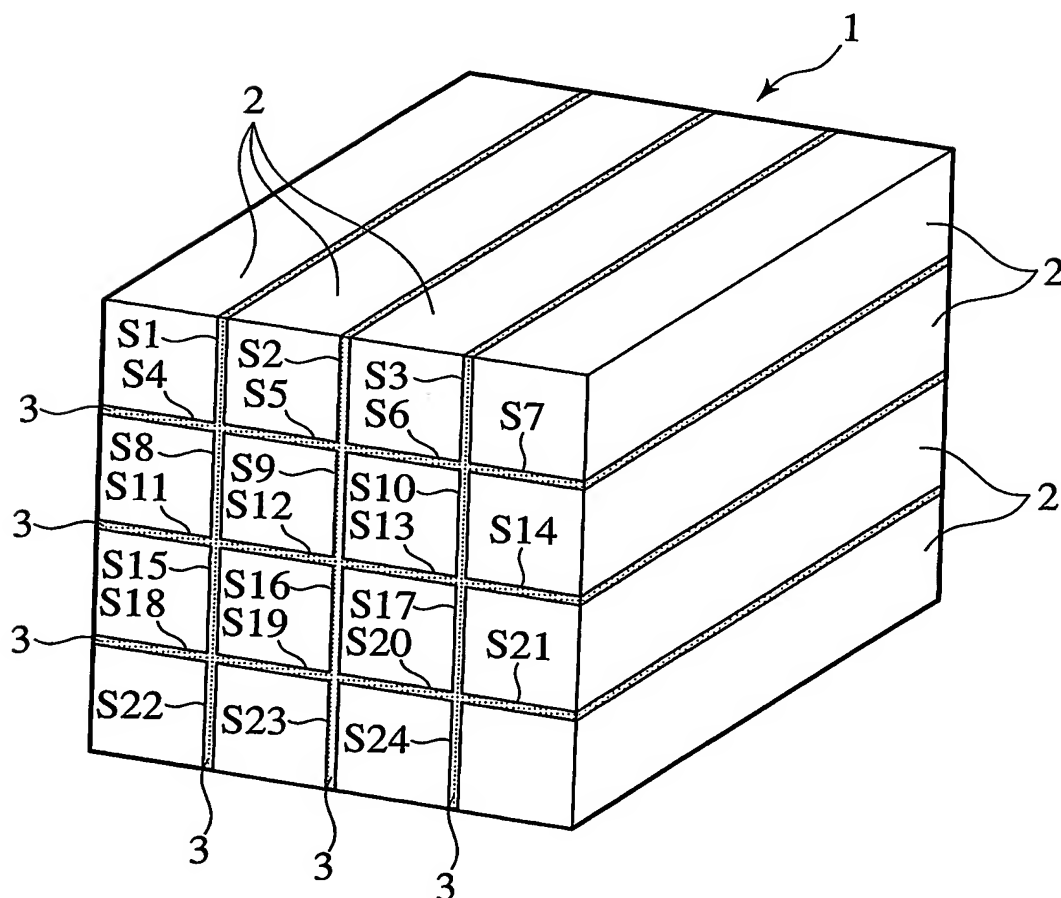


FIG.6B



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/000199

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ C04B37/00, B01D39/20, B01D46/00, B01J32/00, B01J35/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ C04B37/00, B01D39/20, B01D46/00, B01J32/00, B01J35/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X A	WO 03/61924 A1 (NGK INSULATORS, LTD.), 31 July, 2003 (31.07.03), Full text & JP 2002-015355 A Full text	1. 2-3
A	JP 2002-219317 A (Ibiden Co., Ltd.), 06 August, 2002 (06.08.02), Par. Nos. [0037] to [0038] (Family: none)	1-3
A	JP 2000-007455 A (Ibiden Co., Ltd.), 11 January, 2000 (11.01.00), Full text (Family: none)	1-3

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
11 March, 2004 (11.03.04)

Date of mailing of the international search report
30 March, 2004 (30.03.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ C04B37/00, B01D39/20, B01D46/00, B01J32/00, B01J35/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁷ C04B37/00, B01D39/20, B01D53/86, B01J32/00, B01J35/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2004年
 日本国実用新案登録公報 1996-2004年
 日本国登録実用新案公報 1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX	WO 03/61924 A1 (NGK INSULATORS, LTD.) 2003. 07. 31, 全文 & JP 2002-015355 A, 全文	1
A		2-3
A	JP 2002-219317 A (イビデン株式会社) 2002. 08. 06, [0037] - [0038] (ファミリーなし)	1-3
A	JP 2000-007455 A (イビデン株式会社) 2000. 01. 11, 全文 (ファミリーなし)	1-3

☐ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に関する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

11. 03. 2004

国際調査報告の発送日

30. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

村守 宏文

4T

9729

電話番号 03-3581-1101 内線 6791